



LOTPASTE SC BLF06

Wasserlöslich, Typ ISO 1.2.3.C

Die Lotpaste SOLDER CHEMISTRY SC BLF06 wurde schon in der Entwicklung auf bleifreie Anwendungen ausgerichtet, was dieses hochentwickelte SMT-Produkt besonders auszeichnet. Das Flußmittel ist zudem vor, genauso wie nach dem Löten leicht entfernbar. Ihrer Entwicklung liegen die hohen Anforderungen der Kunden auf dem Gebiet Hybrid-Schaltungen und SMT, insbesondere im HF-Bereich, als auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen zugrunde.

Die SC BLF06 ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem Weichlotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf wasserlöslicher Harzbasis, das der Kl. RE L0 nach J-STD-004 entspricht. Sie ist halogenfrei und gehört zu den allerbesten wasserwaschbaren Lotpastentypen.

Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Lagerzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- *SC BLF06* Weicher, nur mit Wasser restlos entfernbarer Rückstand
- *SC BLF06* Stundenlang nicht nachlassend hohe Klebrigkeit
- *SC BLF06* immun gegen Luftfeuchte - tagelang!
- *SC BLF06* Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang!
- *SC BLF06* Exzellente Lötresultate mit glänzenden Lötstellen auch nach dem Waschen!
- *SC BLF06* Für „fine pitch“-Anwendungen sehr zu empfehlen

PHYSIKALISCHE DATEN

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	<u>Schmelzpunkt</u>	Gemäß Internationalem Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:	
Sn96,5/Ag3,5	221°C	Kl.3	25 – 45 µm
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	217 – 219°C	Kl.4	20 – 36 µm
Sn96,5/Ag3/Cu0,5	217°C	Kl.5	10 – 25 µm
Sn99,3/Cu0,7	227°C		

VISKOSITÄT (Pa.s) +/-10% gemessen nach Brookfield RVT-DV-II Viskosimeter bei 90% Metallgehalt:

Korngröße	Viskosität
Fein (T3)	900

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Die Werte von S.I.R. entsprechen denen vom Träger der Leiterplatten, da die Fluxrückstände völlig und restlos nur mit Wasser ohne Zusätze entfernt werden können!

Qualifikationen

Die Lotpaste SC BLF06 ist eine sogenannte wasserlösliche Paste, die die höchste Anforderungen auf diesem Gebiet in Erfüllung bringt. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der F-SW 33 entsprechende, Rückstände, die **wegen ihrer Wasserlöslichkeit ausnahmslos von der Leiterplatte entfernt werden müssen!!!**

Lagerung

Ungeöffnetes Gebinde bei ca. 20°C (RT) : 6 Monate

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, wie auch immer, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird.

Verbraucherhinweise

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst fest verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren als Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen darf man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15-100 mm/s.

Merke(!) Der Pastendruker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in Ihrer Linie. Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 89% Metallgehalt empfohlen

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen. Der SC Schablonenreiniger ist hier zu empfehlen. Die Lotpaste ist mit allen gängigen Reflow-Systemen auch unter Schutzgas aufschmelzbar.

WASCHHINWEIS !

Das Flux unserer SC BLF06 ist vor und nach dem Löten **biologisch vollständig abbaubar! Die Belastung des Abwassers , z.B. nach dem Gebrauch von 2kg SC BLF06, ist geringer als ein einziger Waschvorgang in einem durchschnittlichem Haushalt.**

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste

Legende	Pastentyp	Korngröße	Legierung	Flußmittelanteil	Gebindegröße
z.B.	SC BLF06	T3	96,5/3,5Ag	10%	500g
	SC BLF06	T3	97/Cu3	10%	200g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste(SC...) L-Sn96,5/Ag3,5 / F-SW 32 / 90-3 200g(Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut

Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020

e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.